

产品功能

表面微观三维结构测量，表面三维粗糙度非接触测量。

检测对象

精密光学元件，微纳加工器件，金属机加工零件。

面向行业

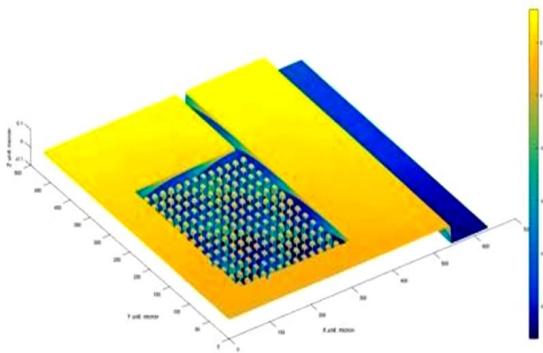
半导体，汽车，太阳能，精密光学等从事表面分析的各类科研院所及企业。



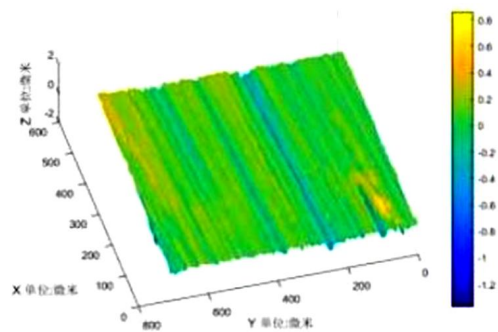
◆ 主要技术指标

1. 纵向测量重复性：0.5nm（PSI 模式） 纵向分辨率： 2nm
2. 纵向测量范围：15mm
3. 高度测量示值误差： <3%
4. 配备超高横向分辨率测量功能（横向分辨 100nm）
5. 丰富的三维特征分析软件和粗糙度分析功能
6. 采用抗震性硬件结构和软件算法设计

◆ 测量实例



VLSI 纳米台阶标准块三维测量结果



磨削加工表面三维微观结构测量